

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

17.07.03

REC'D 05 SEP 2003

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 7 月 1 8 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 1 0 1 5 2
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 2 1 0 1 5 2]

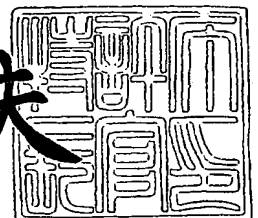
出 願 人 本 田 技 研 工 業 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 8 月 2 1 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



Best Available Copy

【書類名】 特許願

【整理番号】 H102-2046

【提出日】 平成14年 7月18日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B21C 23/00

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市狭山1丁目10番地1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 船木 光弘

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市狭山1丁目10番地1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 馬場 大樹

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市狭山1丁目10番地1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 大山 真哉

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市狭山1丁目10番地1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 堀向 俊之

【特許出願人】

【識別番号】 000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100085257

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山 有

【選任した代理人】

【識別番号】 100103126

【弁理士】

【氏名又は名称】 片岡 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038807

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9722915

【包括委任状番号】 9304817

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 銅合金

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 室温で固溶しないか殆んど固溶しない第 2 の元素を含んだ銅合金において、この合金の平均結晶粒径は $20\ \mu\text{m}$ 以下で、結晶粒子間に前記第 2 の元素が析出していることを特徴とする銅合金。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の銅合金において、この銅合金は硬度が 30 (HRB) 以上、導電率が 85 (IACS%) 以上、熱伝導率が 350 (W/(m·K)) 以上であることを特徴とする銅合金。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 に記載の銅合金において、前記第 2 の元素は、Cr (クロム)、ジルコニウム (Zr)、ベリリウム (Be)、チタン (Ti)、ホウ素 (B) のうちの何れかであることを特徴とする銅合金。

【請求項 4】 請求項 1 乃至請求項 3 に記載の銅合金において、この銅合金は溶接電極用の素材であることを特徴とする銅合金。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、溶接の電極材料として好適する銅合金に関する。

【0002】

【従来の技術】

金属材料の結晶組織の微細化を図ることで機械的強度が向上することが、ホール・ペッチの法則として知られている。

例えば、金属や合金材料を変形すると、加工硬化によって材料強度が上昇する。これは加工（塑性変形）によって、材料中に種々の欠陥（点欠陥、転位、積層欠陥など）が蓄積し、これら欠陥の相互作用の結果、新しい欠陥の導入・移動が困難になり、外力に対する抵抗を持つことになるからと理解されている。

【0003】

金属材料に塑性変形（歪）を与えるには、従来から、押し出し、引き抜き、せん断、圧延、鍛造などが行われている。

具体的には、材料に高圧をかけながらねじる H P T (High Pressure Torsion) 法、括れのついたパイプの中を繰り返し通す C E C (Cyclic Extrusion Compression) 法、圧延で薄くなった金属板を切断して重ね合わせ繰り返し圧延する A R B (Accumulative Roll Bonding) 法が提案され、特にアルミニウム合金に対しての微細化の具体的方法として、特開平 9-137244 号公報、特開平 10-258334 号公報、特開平 11-114618 号公報、特開 2000-271621 号公報などに開示される材料の断面減少を伴わないで側方押し出しでせん断変形を与える E C A E 法が提案されている。

【0004】

一方、銅合金については特開平 11-140568 号公報、特開 2000-355746 号公報などに開示される方法が提案されている。この先行技術は銅合金のうちでも、水栓金具などの材料として使用される黄銅 (C u - Z n) の特性 (切削性と脱亜鉛腐食) を改善するために、熱間押し出しによって動的再結晶を起こさせ、結晶の微細化と特定の結晶組織割合 (α 相、 β 相、 γ 相の割合) が得られるようにしたものである。

【0005】

また、クロム (C r)、ジルコニウム (Z r)、ベリリウム (B e)、チタン (T i) 或いはホウ素 (B) などの室温で固溶しないか殆んど固溶しない元素を添加した時効硬化型の銅合金に対して所定の特性を引き出すには、先ず、溶体化処理によって、前記元素を高温で十分に固溶させた後、急冷して過飽和状態とし、この後所定の温度で時効処理することで過飽和状態となっていた添加元素を析出せしめるようにしている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

上述したアルミニウム合金や銅合金に対する加工硬化或いは時効処理をそのままクロム (C r)、ジルコニウム (Z r)、ベリリウム (B e)、チタン (T i) 或いはホウ素 (B) など添加した時効硬化型の銅合金に対して適用しても、機械的強度と熱的特性及び電気的特性の全てを両立させることができない。

【0007】

即ち、例えば電極材料として要求される熱的特性及び電気的特性を銅合金に発現せしめるには、固溶している添加元素をできるだけ多量に析出する必要がある。そして、多量に析出せしめるには時効温度を高める必要があるが、温度を高めると粒成長が進み機械的特性が低下してしまう。即ち、機械的強度と熱的・電気的特性とはトレードオフの関係にある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明に係る銅合金は、Cr（クロム）、ジルコニウム（Zr）、ベリリウム（Be）、チタン（Ti）、ホウ素（B）などの室温で固溶しないか殆んど固溶しない第2の元素を含んだ銅合金であって、平均結晶粒径は20 μ m以下で、結晶粒子間に前記第2の元素が析出している構成とした。

【0009】

上記の構成の銅合金を得るには、例えば、高温で上記第2の元素を十分に母材金属（Cu）に固溶させ、次いで急冷して過飽和状態の素材を得た後（溶体化処理）、この素材に歪を与えて結晶の微細化を図る。

【0010】

素材に歪を与える手段としては、例えば、材料に対し側方押出しでせん断変形を与えるECAE法とし、歪としては200%以上の伸びに相当するものとする。

歪を与える前の素材としては、溶体化処理したままのものでも所望する性能は得られるが、溶体化処理後に時効処理を施し、結晶粒間に第2の元素が析出しているものがより好ましい。

また、歪を与える際の押出し温度（金型温度）を400～500℃とし、押出し速度を約1mm/secとすることで、押出しと同時に時効処理を行って、結晶粒間に第2の元素の析出を促すようにしてもよい。勿論、押出しとは別に時効処理を施してもよい。

【0011】

上記構成とすることで、スポット溶接、アーク溶接、プラズマ溶接などの電極

材料として好ましい特性、例えば、硬度が 30 (HRB) 以上好ましくは 40 (HRB) 以上、導電率が 85 (IACS%) 以上好ましくは 90 (IACS%) 以上、熱伝導率が 350 (W/(m·K)) 以上好ましくは 360 (W/(m·K)) 以上の銅合金が得られる。

【0012】

【発明の実施の形態】

以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。図1は本発明に係る銅合金を得る工程を説明した図であり、先ず、母材 (Cu) に Cr : 0.1 ~ 1.4 wt% 溶融し、これを急冷して Cu に Cr が過飽和に固溶した素材を得る。次いでこの素材に 200% 以上の伸びに相当する歪を与える。尚、素材としては溶体化処理の後に時効処理がなされているものが好ましい。

添加元素が Zr の場合は、0.15 ~ 0.5 wt%、Be の場合は、0.1 ~ 3.0 wt%、Ti の場合は 0.1 ~ 6.0 wt%、B の場合は 0.01 ~ 0.5 wt%、とする。

【0013】

歪を与える具体的手段は、金型温度を 400 ~ 500℃ とし、押し出し速度を約 1 mm/sec とし、4 回繰り返して押し出す (EACE 処理)。このように Cr が過飽和に固溶した銅合金素材に歪を与える。この操作で、結晶粒径は 200 μm が 20 μm 以下となる。

【0014】

ここで、 Δe : 歪量、 ϕ : 接合内角の 1/2、ERR : 加工前後の面積比、 A_0 : 加工前の断面積、 A : 加工後の断面積、EAR : 加工前後の相当断面積減少率、EE : 相当歪 (伸び) とすると、以下の関係が成立する。

$$\Delta e = 2 / \sqrt{3} \cot \phi$$

$$ERR = A_0 / A = \exp (\Delta e)$$

$$EAR = (1 - 1 / ERR) \times 100$$

$$EE = (ERR - 1) \times 100$$

【0015】

上記の側方押し出し (EACE 処理) によって結晶組織が微細化する。そして押

出し条件が時効処理と重なるため、微細化と同時に第2元素の析出も助長される。

このEACE処理によって得られた銅合金の結晶組織を図2(a)の顕微鏡写真に示す。またEACE処理前の結晶組織を同図(b)の顕微鏡写真に示す。これら顕微鏡写真から、EACE処理によって結晶粒子間に添加元素が析出(写真の黒い点)していることが分かる。

【0016】

図3は金型温度と硬度との関係を示すグラフ、図4は金型温度と導電率との関係を示すグラフ、図5は金型温度と熱伝導率との関係を示すグラフであり、これらのグラフから本発明にかかる銅合金は、溶接チップなどの電極材料として要求される特性、即ち、硬度30(HRB)以上、導電率85(IACS%)以上、熱伝導率350(W/(m·K))以上であることが分る。

【0017】

即ち、図3～5からは、EACE処理を施していない素材(溶体化処理+時効処理)は硬度は高いが、導電率と熱伝導率に劣り、溶体化処理のみを施した素材にEACE処理を施した素材は硬度は低くなるものの、導電率と熱伝導率に優れ、更に溶体化処理後に時効処理を施した素材にEACE処理を施した素材は、硬度、導電率、熱伝導率の全てに優れることが分る。

【0018】

従来のように単に時効処理を行っていたものより、写真からも明らかなように、歪を与えて時効すると、第2の元素が成分中のC、O、B、N等の不純物と反応し、炭化物、酸化物、硼化物、窒化物といった形で析出する。時効析出物が従来より増すことで、成分中の銅以外の元素が減少し、マトリックスは純銅に近い成分となり上記の特性が向上すると考えられる。同様の理由で、硬度が低下する現象も理解できる。

【0019】

図6は本発明に係る銅合金と従来の銅合金の溶接性をスパッタ発生、張付きの有無で比較したグラフであり、本発明にかかる銅合金はアルミナ分散銅および時効処理前の銅合金に比較して、適正な電流条件は同等であり、また張り付きが生

じない。

【0020】

図7は本発明に係る銅合金と従来の銅合金の溶接性を連続打点数で比較したグラフであり、本発明にかかる銅合金を溶接チップとした場合には、1475打点が可能であった。

【0021】

【発明の効果】

以上に説明したように本発明に係る銅合金は、結晶組織が微細で且つ結晶粒子間に添加元素が多量に析出しているため、従来トレードオフの関係にあった機械的強度と熱的・電気的特性を両立させることができる。

特に、溶接チップなどの電極材料として要求される特性、具体的には硬度30(HRB)以上、導電率85(IACS%)以上、熱伝導率350(W/(m・K))以上の銅合金を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る銅合金を得る工程を説明した図

【図2】

(a)は本発明に係る銅合金の結晶組織を示す顕微鏡写真

(b)はEACE処理前の結晶組織を示す顕微鏡写真

【図3】

金型温度と硬度との関係を示すグラフ

【図4】

金型温度と導電率との関係を示すグラフ

【図5】

金型温度と熱伝導率との関係を示すグラフ

【図6】

本発明に係る銅合金と従来の銅合金の溶接性をスパッタ発生、張付きの有無で比較したグラフ

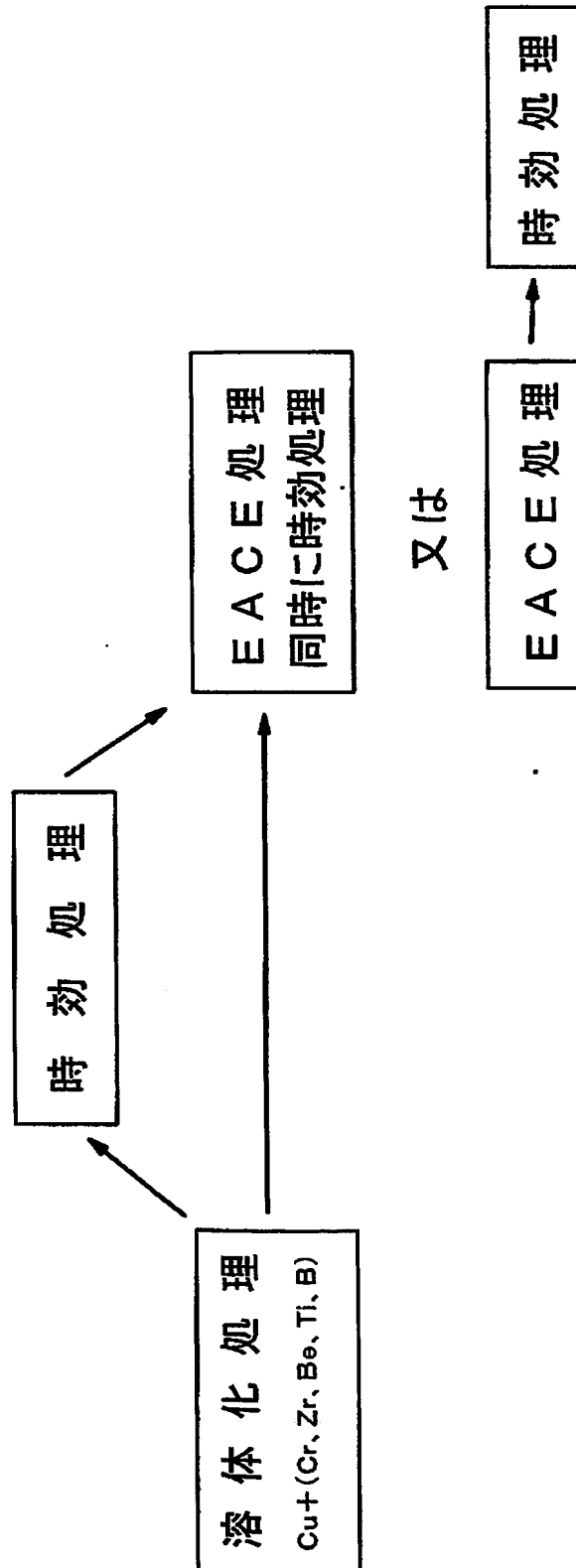
【図7】

本発明に係る銅合金と従来の銅合金の溶接性を連続打点数で比較したグラフ

【書類名】

図面

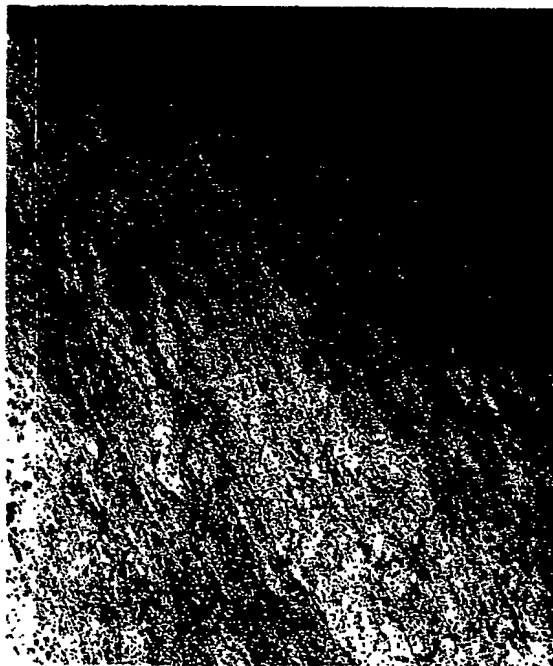
【図 1】



【図 2】

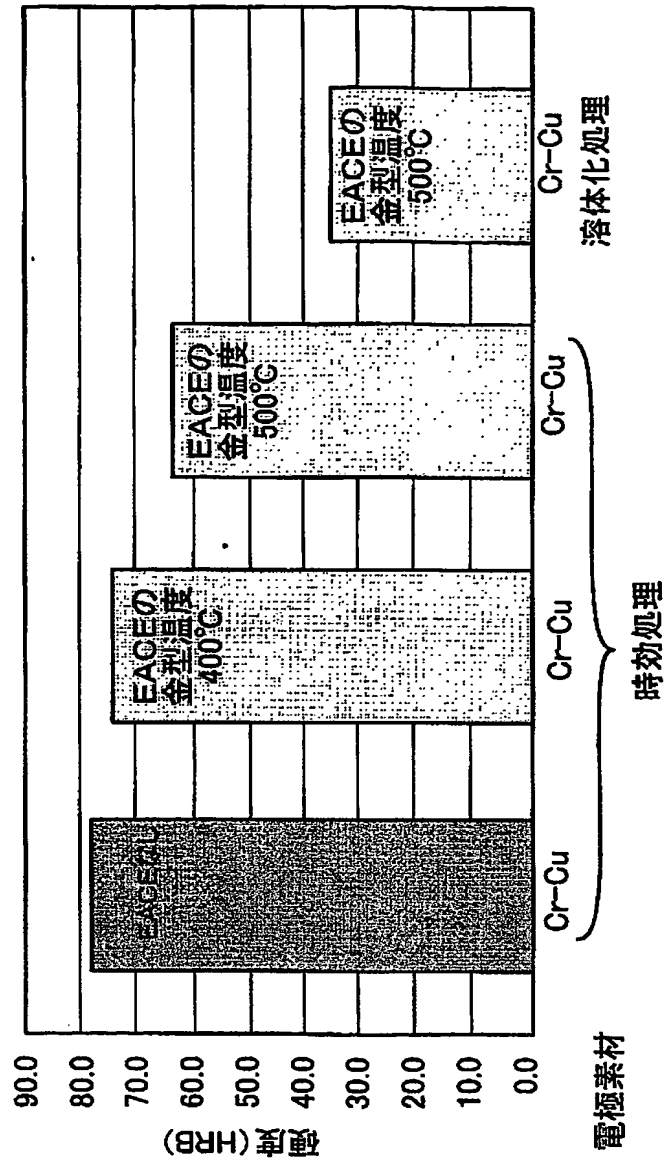


(b)



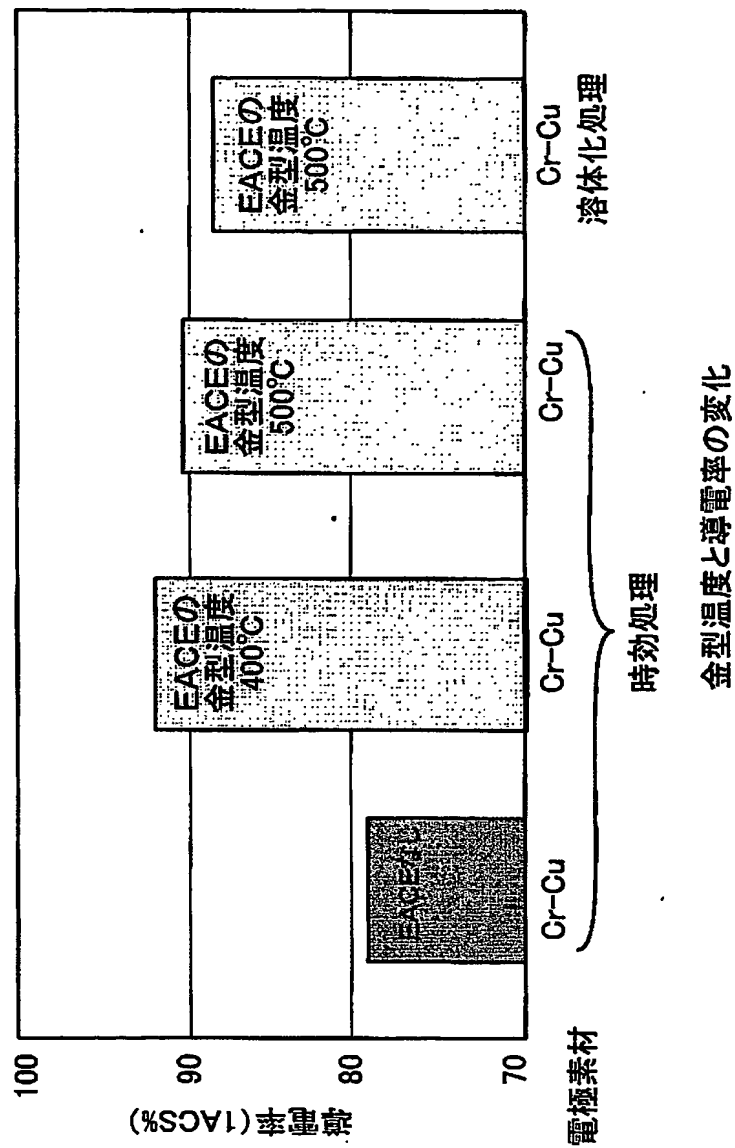
(a)

【図 3】

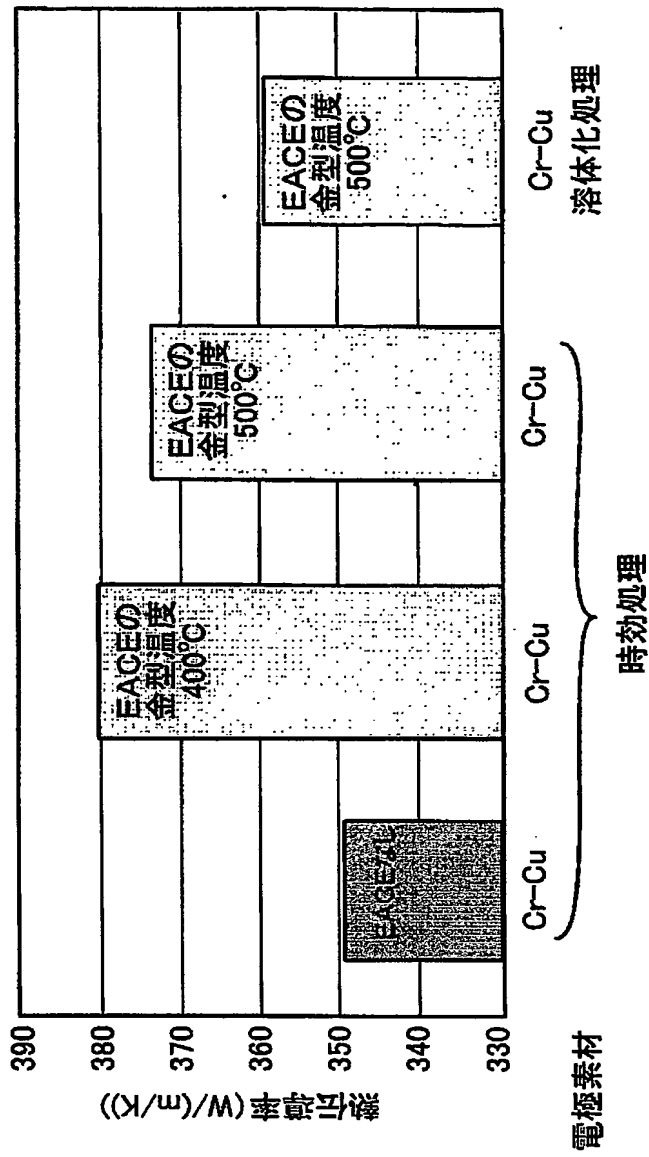


金型温度と硬度の変化

【図 4】

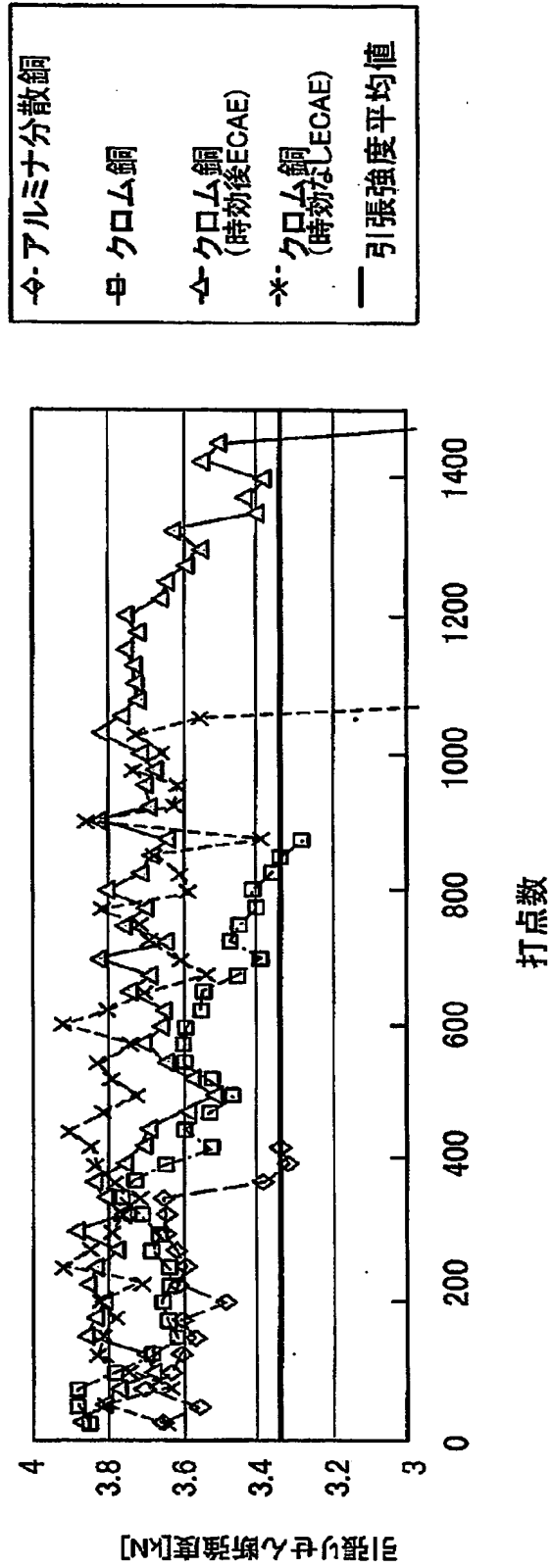


【図 5】

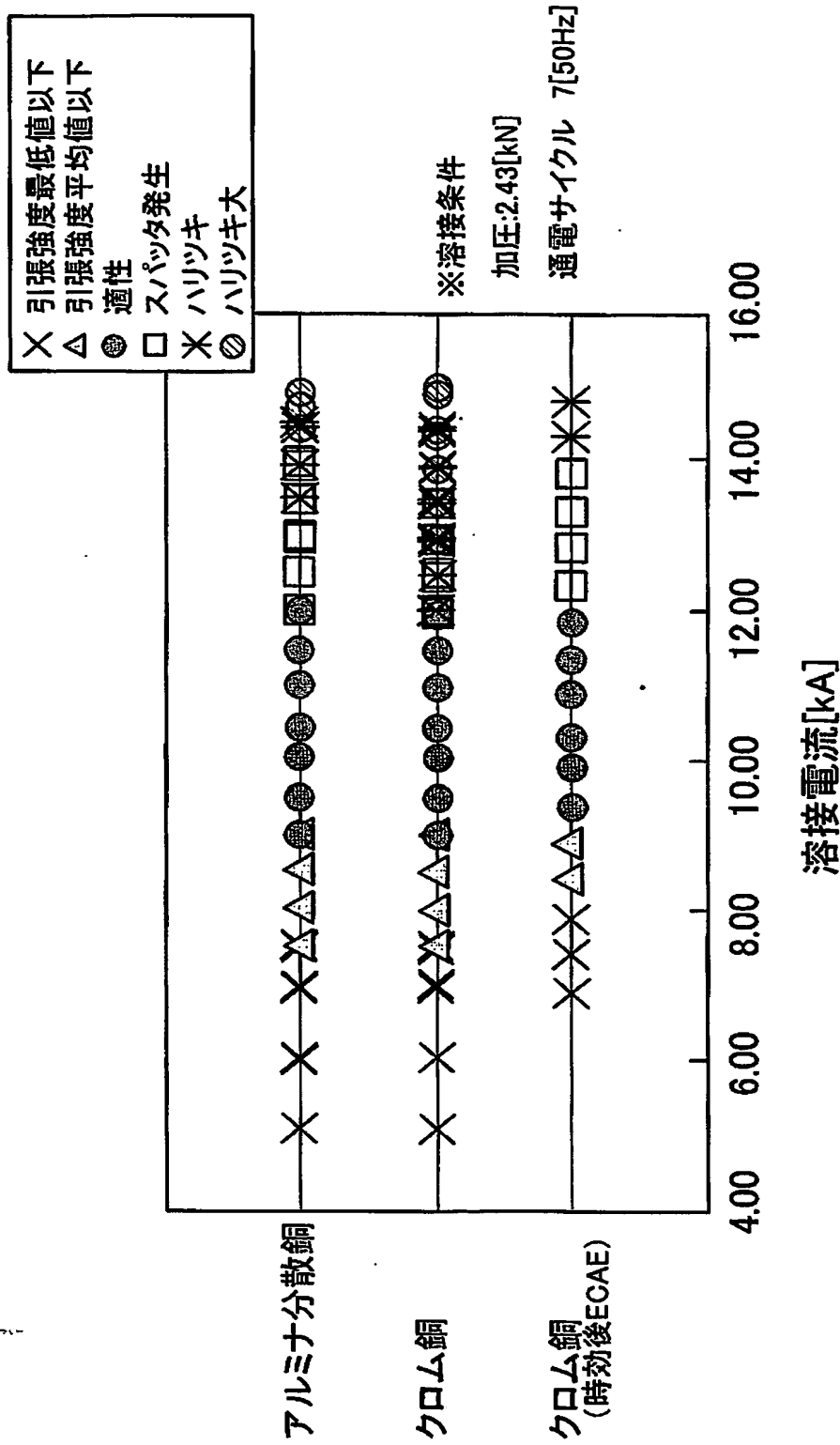


金型温度と熱伝導率の変化

【図6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【課題】 機械的強度と熱的・電気的特性に優れた銅合金を提供する。

【解決手段】 高温でCrなどの元素を十分に母材金属（Cu）に固溶させ、次いで急冷して過飽和状態の素材を得た後、この素材に歪を与え、更にこの歪を与えるのと同時にまたは歪を与えた後に低温で時効処理を行う。これによって、電極材料として好ましい特性、例えば、硬度が30（HRB）以上、導電率が85（IACS%）以上、熱伝導率が350（W/（m・K））以上の銅合金が得られる。

【選択図】 図1

特願2002-210152

出願人履歴情報

識別番号

[000005326]

1. 変更年月日

1990年 9月 6日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目1番1号

氏 名

本田技研工業株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☒ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.